

EUROPEAN PATENT OFFICE

A6

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER : 2003023019
PUBLICATION DATE : 24-01-03

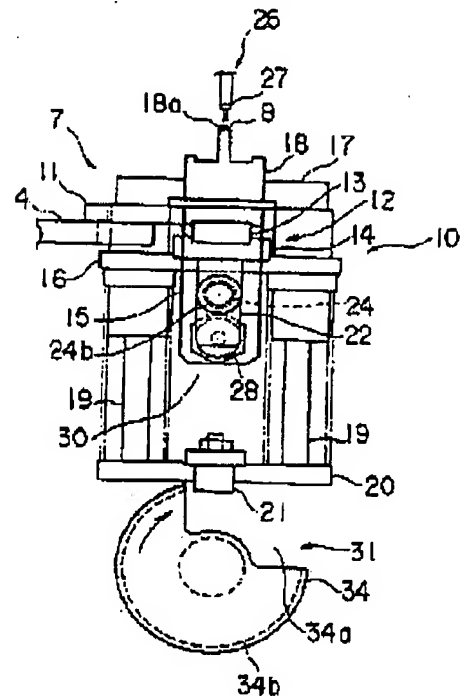
APPLICATION DATE : 05-07-01
APPLICATION NUMBER : 2001204874

APPLICANT : TOKYO WELD CO LTD;

INVENTOR : HIRAI KOJI;

INT.CL. : H01L 21/50 H01L 23/50

TITLE : APPARATUS AND METHOD FOR
SEPARATING/TRANSFERRING
ELECTRONIC COMPONENT



ABSTRACT : **PROBLEM TO BE SOLVED:** To provide an apparatus for separating/transferring electronic components capable of increasing the transferring speed of the electronic components to correspond with the speed of separating/transferring means for transferring the components from a separating/transferring part to the next process.

SOLUTION: In the separating/transferring apparatus composed of a stamping part 9 for stamping out a plurality of electronic components 2 arranged in the width direction and the longitudinal direction of a lead frame 1 from the lead frame 1 and separating them into individual electronic component columns 8, a transfer table 4 for rotatably transferring the electronic component column 8 stamped out at the stamping part 9, and a separating/transferring part 10 for separating the electronic component column 8 transferred by the transfer table 4 into individual electronic components 2 and transferring them to the next process, the apparatus is characterized in that the transfer table 4 is provided with a plurality of transfer mechanisms 7, and the electronic component column 8 is placed on the transfer mechanism 7 to be transferred from the stamping part 9 to the separating/transferring part 10.

COPYRIGHT: (C)2003,JPO

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号
特開2003-23019
(P2003-23019A)

(13) 公開日 平成15年1月24日 (2003.1.24)

(51) Int.Cl.⁷H 0 1 L 21/50
23/50

識別記号

F I

H 0 1 L 21/50
23/50

キーワード(参考)

C E F 0 6 7
B
Z

審査請求 未請求 請求項の数10 O L (全 6 頁)

(21) 出願番号 特願2001-204874(P2001-204874)

(22) 出願日 平成13年7月5日(2001.7.5)

(71) 出願人 591009705

株式会社 東京ウエルズ
東京都大田区北馬込2丁目28番1号

(72) 発明者 平川 文廣

東京都大田区北馬込2丁目28番1号 株式
会社東京ウエルズ内

(72) 発明者 服部 省悟

東京都大田区北馬込2丁目28番1号 株式
会社東京ウエルズ内

(74) 代理人 100058479

弁理士 鈴江 武彦 (外5名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 電子部品の分離・搬送装置及び分離・搬送方法

(57) 【要約】

【課題】電子部品の搬送速度を高速化し、分離・搬送部から次の工程に移送する分離・搬送手段の速度に対応させることができる電子部品の分離・搬送装置を提供することにある。

【解決手段】リードフレーム1の幅方向及び長手方向に配列された複数の電子部品2を、前記リードフレーム1から打抜いて個々に分離した電子部品列8とする打抜き部9と、この打抜き部9で打抜かれた前記電子部品列8を回転搬送する搬送テーブル4と、この搬送テーブル4により搬送された前記電子部品列8を個々の電子部品2に分離し、次の工程に移送する分離・搬送手段26を有する分離・搬送部10とからなる分離・搬送装置において、前記搬送テーブル4に複数の搬送機構7を設け、前記搬送機構7に前記電子部品列8を載置して前記打抜き部9から前記分離・搬送部10へ搬送することを特徴とする。

